

# PRESSEINFORMATION

FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR ZUVERLÄSSIGKEIT UND MIKROINTEGRATION IZM

---

**PRESSEINFORMATION**

11. August 2014 || Seite 1 | 3

---

## Professur für AVT-Experten

**Die Fachkunde für zuverlässige Aufbautechniken und Systemintegration wird in Berlin ausgebaut. Denn mit Martin Schneider-Ramelow ist ein international anerkannter Spezialist für Qualität und Zuverlässigkeit von Drahtbondverbindungen nun von der Technischen Universität Berlin zum Honorarprofessor bestellt worden.**

Auf Vorschlag der Fakultät IV – Elektrotechnik und Informatik traf der Akademische Senat der TU Berlin den Beschluss, Schneider-Ramelow in Würdigung seiner hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen zum Honorarprofessor für „Elektronikwerkstoffe / Elektronische Aufbautechnologien“ zu bestellen.

Prof. Schneider-Ramelow, der bereits seit über 20 Jahren an der TU Berlin lehrt und am Fraunhofer IZM Abteilungsleiter im Bereich der Verbindungstechniken ist, stärkt somit die Verankerung anwendungsbezogener Forschung und Lehre und zugleich die Partnerschaft zwischen der TU Berlin und dem Fraunhofer IZM.

### Zur Person

1964 im Emsland geboren, studierte Martin Schneider-Ramelow von 1987 bis 1991 Werkstoffwissenschaften an der Technischen Universität Berlin und promovierte dort 1998 im Fachgebiet Werkstofftechnik. Von 1991 bis 1998 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin zunächst für ein Jahr am Institut für Metallurgie, Metallhüttenkunde und dann am Institut für Werkstofftechnik tätig.

Seit August 1998 war er als Projekt- und Gruppenleiter (Chip & Wire Technologies) am Fraunhofer IZM in Berlin beschäftigt und leitet derzeit dort die Abteilung System Integration & Interconnection Technologies.

Seit 2001 hat er an der TU Berlin den Lehrauftrag für „Werkstoffe und physikalisch-chemische Prinzipien der Systemintegration“. Er ist Autor von über 100 Publikationen und arbeitet aktiv in diversen nationalen und internationalen Konferenz-Programm-Komitees mit.

Darüber hinaus ist er seit 2009 Erster Vorsitzender von IMAPS Deutschland (International Microelectronics Assembly and Packaging Society), wo er für die Vernetzung von über 300 hochrangigen Experten aus dem gesamten Gebiet der Mikroelektronik in Deutschland verantwortlich ist.

Er ist zudem Obmann der Arbeitsgemeinschaft „Bonden“ im Deutschen Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. (DVS) sowie IEEE Senior Member.



---

**PRESSEINFORMATION**

11. August 2014 || Seite 2 | 3

---

Prof. Dr.-Ing. Martin Schneider-Ramelow ©Fraunhofer IZM  
Bild in Druckqualität: [http://www2.izm.fraunhofer.de/Bilder/Pic\\_Schneider-Ramelow.zip](http://www2.izm.fraunhofer.de/Bilder/Pic_Schneider-Ramelow.zip)

Weitere Infos zu Prof. Martin Schneider-Ramelow:  
[http://www.izm.fraunhofer.de/de/kontakt/mitarbeiter/martin\\_schneider-ramelow.html](http://www.izm.fraunhofer.de/de/kontakt/mitarbeiter/martin_schneider-ramelow.html)

---

---

**PRESSEINFORMATION**

11. August 2014 || Seite 3 | 3

---

---

Die **Fraunhofer-Gesellschaft** ist die führende Organisation für angewandte Forschung in Europa. Unter ihrem Dach arbeiten 67 Institute an Standorten in ganz Deutschland. Mehr als 23 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten das jährliche Forschungsvolumen von 2 Milliarden Euro. Davon fallen 1,7 Milliarden Euro auf den Leistungsbereich Vertragsforschung. Über 70 Prozent dieses Leistungsbereichs erwirtschaftet die Fraunhofer-Gesellschaft aus Aufträgen der Industrie und öffentlich finanzierten Forschungsprojekten. Internationale Niederlassungen sorgen für Kontakt zu den wichtigsten gegenwärtigen und zukünftigen Wissenschafts- und Wirtschaftsräumen.

Das **Fraunhofer IZM**: Unsichtbar – aber unverzichtbar: nichts funktioniert mehr ohne hoch integrierte Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik. Grundlage für deren Integration in Produkte ist die Verfügbarkeit von zuverlässigen und kostengünstigen Aufbau- und Verbindungstechniken. Das Fraunhofer IZM, weltweit führend bei der Entwicklung und Zuverlässigkeitsbewertung von Electronic Packaging Technologien, stellt seinen Kunden angepasste Systemintegrationstechnologien auf Wafer-, Chip- und Boardebene zur Verfügung. Forschung am Fraunhofer IZM bedeutet auch, Elektronik zuverlässiger zu gestalten und seinen Kunden sichere Aussagen zur Haltbarkeit der Elektronik zur Verfügung zu stellen.

---

**Fachlicher Ansprechpartner**

**Prof. Dr.-Ing. Martin Schneider-Ramelow** | Telefon +49 30 46403-270 | martin.schneider-ramelow@izm.fraunhofer.de | Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM, Berlin | www.izm.fraunhofer.de

**Presse**

**Georg Weigelt** | Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM | Telefon +49 30 46403-279 | Gustav-Meyer-Allee 25 | 13355 Berlin | www.izm.fraunhofer.de | georg.weigelt@izm.fraunhofer.de